

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的策略」。

### [編纂]用途

我們估計，經扣除[編纂]開支後，我們將收到[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件指示性[編纂]的中位數）。我們擬將[編纂]淨額用於以下用途（按本文件所述[編纂]範圍的中位數計）：

#### 研發

約[編纂]%或[編纂]港元用於持續提升我們的研發能力和解決方案供應，包括：

#### *CIM*產品功能及解決方案

約[編纂]%或[編纂]港元將用於強化我們的CIM產品力及解決方案，旨在打造國內領先的12寸前道CIM系統，並確保我們CIM系統的穩定運行及廣泛採用。具體而言，我們計劃通過以下舉措提升項目質量、增加項目成功率及提高我們的市場認可度：

- 建立一支高素質的研發團隊，能夠開發出與國際接軌的12寸前道CIM產品和解決方案。
- 改善智能計算中心的基礎設施，提升其算力及資源配置能力，為我們的項目研發及運營提供更強大的技術硬件支持；及
- 構建MES大模型能力，融合人工智能、機器學習技術，提升智能算力及服務水平。

我們計劃在未來兩年內為我們的研發團隊招聘26名人員專門負責此項工作。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
產業顧問.....	6	本科或以上學歷；及具有智能製造、CIM軟件及MES/自動化實施等經驗。	10年以上。	[編纂]
軟件架構師.....	6	計算機科學或相關領域的本科或以上學歷；及深入了解主流大數據系統原理、源代碼和數據庫。	8年以上大數據行業經驗；及5年以上大數據架構設計經驗。	[編纂]

## 未來計劃及[編纂]用途

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
軟件開發工程師.....	6	本科或以上學歷；精通Java程序設計、主流系統架構、應用中間件及運維。	5年以上。	[編纂]
質量經理.....	6	機械、電子、材料、質量管理或相關領域的本科或以上學歷；熟悉軟件質量保證程序及數據分析工具；及項目管理方面的專業知識和方法。	5年以上軟件及/或硬件開發企業質量管理的經驗。	[編纂]
研發經理.....	2	本科或以上學歷；及具備管理研發中心或實驗室的經驗	10年以上。	[編纂]

我們計劃將我們的研發團隊安置在中國及海外的多個地點，這符合可用的人才儲備及我們的海外擴張戰略。詳情請參閱下文「— 新增辦公室及實驗室」。

我們將在未來三年內購買額外的硬件及軟件以支持研發團隊，其中包括助力開發及測試指定產品及平台的新服務器及算力卡，以及額外電腦設備用於一般開發及測試目的。

### AI應用

約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設我們在泛半導體行業的AI應用能力。利用AI和大模型能力，我們的目標是打造統一的人工智能製造中央控制平台，使LOFA AI能夠取代現場操作人員，擔任工程師助手及通過生產流程的智能自動化，協助管理層快速決策。我們計劃擴展LOFA目前針對現場操作人員的功能，使其涵蓋工程輔助和管理輔助功能。這就需要結合人工智能和大模型的能力，打造一個獨立的工業人工智能模型。

具體而言，我們計劃通過以下舉措升級及優化我們的LOFA產品：

- 建立LOFA工廠行業知識庫模型，強化LOFA產品應用場景，從單純提升現場作業能力發展為優化與工程師的協同決策；
- 開發多個管理模塊升級LOFA產品，提升產品開發和模塊化部署能力；
- 成立LOFA AI計算應用，建立我們的數據集，構建軟硬件相結合的一體化研發平台；及
- 組建集泛半導體行業經驗、現場經驗、AI技術能力、軟件開發能力於一體的內部研發團隊。

## 未來計劃及[編纂]用途

我們計劃在未來兩年內為研發團隊招聘26名人員專注AI應用。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
AI工程師 .....	3	計算機科學、自動化、電氣工程或技術領域的本科或以上學歷；熟練掌握程式語言；及了解機器學習/深度學習並具備數學基礎。	3年以上人工智能／機器學習開發經驗。	[編纂]
產業顧問.....	3	本科或以上學歷；且具有智能製造、CIM軟件及MES／自動化實施、半導體相關產業的工廠建設及工藝經驗。	10年以上。	[編纂]
現場應用工程師.....	3	電子相關領域的本科或以上學歷；及了解CIM+AI軟件產品。具備部署、故障排除和支持CIM + AI 軟件產品的專業知識。	3年以上。	[編纂]
軟件平台專家.....	4	計算機科學、電氣工程、自動化或相關領域的本科或以上學歷；及深入了解軟件架構設計原則，並設計及實施可擴展軟件平台架構。	8年以上半導體或相關行業軟件開發經驗。	[編纂]
軟件架構師.....	3	為提升CIM產品能力及解決方案，研發期間將招募的相同職位擁有大致相似的基		[編纂]
軟件開發工程師.....	3	本遴選標準及經驗年資。		[編纂]
質量經理.....	4			[編纂]
研發經理.....	3			[編纂]

我們計劃在中國及海外的不同地點設置相關研發中心及實驗室，安置我們的團隊。詳情請參閱下文「— 新增辦公室及實驗室」。

就我們的AI應用而言，除購買新服務器及算力卡以助力指定產品及平台的開發及測試，以及額外的計算機設備外，我們將在未來三年內獲取行業數據集，以建立訓練數據集，支持在我們的實驗室訓練AI模型。

### 工藝設計與仿真解決方案

約[編纂]%或[編纂]港元將用於建立高端工藝設計與仿真解決方案開發的研發能力。

## 未來計劃及[編纂]用途

具體而言，我們計劃將專用於此用途的[編纂]淨額用於以下舉措：

- 開發及優化光學鄰近修正算法，以及增強及擴展鄰近效應修正和霧化效應修正軟件，以幫助我們的客戶實現更精確的光刻工藝控制；
- 進行電子束光刻機相關修正模型的研究和軟件開發，以實現國產設備精度達到國際一流水平；及
- 組建一支由核心半導體製造工藝專家、算法工程師組成的高端工藝設計與仿真產品研發的內部研發團隊。

我們計劃在未來五年內為我們的研發團隊招聘19名人員，專門負責該研發。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
AI算法專家.....	4	本科及以上學歷；及具有在半導體製造環境下進行人工智能圖像挖掘的經驗。	8年以上機器學習開發經驗；及5年以上的核心深度學習修改經驗。	[編纂]
半導體製程專家.....	4	材料科學與工程、電子科學與技術、微電子、物理電子、化學工程或相關專業的本科或以上學歷；及精通核心半導體製造流程，工藝流程及工藝優化。	5年以上半導體12寸晶圓廠的工藝研發經驗，曾領導過至少一個完整的半導體工藝開發或量產項目。	[編纂]
研發經理.....	3	為提升CIM產品能力及解決方案，研發期間將招募的相同職位擁有大致相似的基		[編纂]
軟件開發工程師.....	8	本遴選標準及經驗年資。		[編纂]

為支持我們的高端工藝設計及仿真解決方案開發工作，我們計劃於上海及台灣設立研究及開發中心，以承擔相關職能。詳情請參閱下文「新增辦公室及實驗室」。

我們將在未來三年內購買執行其專用職能所需的硬件及軟件，包括新服務器及算力卡及其他額外計算機設備。我們亦計劃租賃生產線產能，專門用於試點測試及模擬活動，以對照實際製造流程驗證電子束模擬算法及必要校準的表現。

## 未來計劃及[編纂]用途

### 特定行業組件平台

約[編纂]%或[編纂]港元將分配於開發現有產品的特定行業組件平台，以通過以下舉措降低交付成本。

- 建立產品發佈中心，通過該中心管理產品迭代，並實施自動化產品測試，以降低用戶驗收測試成本和人力需求；
- 通過按行業分解現有項目代碼，細化代碼架構，封裝成模塊化組件，通過集中的平台管理，實現行業組件的模塊化；
- 搭建涵蓋產品設計、開發、用戶驗收測試及上市的一體化研發管理平台，精簡優化設計－研發－上市的全流程；及
- 發展AI大模型能力，實現產品開發、代碼測試審核、架構框架設計的部分自動化。

我們計劃在未來五年內招募22名額外研發人員及在未來三年內購買額外硬件及軟件，以開發我們現有產品的行業特定組件平台。

下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
軟件開發工程師.....	6	為提升CIM產品能力及解決方案，研發期間將招募的相同職位擁有大致相似的基 本遴選標準及經驗年資。		[編纂]
軟件架構師.....	6			[編纂]
質量經理.....	6			[編纂]
研發經理.....	4			[編纂]

儘管由於我們努力優化研發人員及精簡研發團隊，2024年，我們的研發成本有所降低，研發團隊規模也有所縮減，但鑒於(i)上述擴大我們在CIM產品、AI應用、高端工藝設計及仿真解決方案方面的業務能力的需要，以及在我們特定行業組件平台上進行開發的需要；(ii)我們於海外增設辦事處及實驗室的計劃；(iii)我們擴大海外銷售網絡的計劃，我們預期將根據上述計劃招聘員工。

### 新增辦公室及實驗室

約[編纂]%或[編纂]港元將用於租賃及裝修在中國和海外的額外辦公室，作為我們新的研發中心和實驗室，為上述我們的新研發團隊提供場所。

### 12寸前道CIM產品及解決方案團隊：

我們計劃2026年租賃位於中國北京、長沙及成都、新加坡、泰國及馬來西亞的物業，以容納我們的研發團隊成員。各中心的總建築面積擬為300平方米至600平方米。

## 未來計劃及[編纂]用途

### AI應用團隊：

為支持我們的人工智能應用團隊，我們計劃於未來兩年成立五個研發中心，分別於上海、深圳、台灣、新加坡及馬來西亞設立；我們亦計劃2026年在上海、深圳及台灣設立三個專門實驗室以進行平台搭建及算法訓練。我們計劃租賃總建築面積介乎500平方米至800平方米作各研發中心之用的物業；及用作各實驗室的平均總建築面積為1,100平方米的物業。

### 高端工藝設計及仿真解決方案開發團隊：

我們計劃自2026年中期起租賃總建築面積約為1,500平方米的物業，以分別在上海和台灣設立研發中心。

我們目前設有四個研發中心，各司其職，分別專注於不同的職能與領域。其中，**聯合實驗室中心**主要負責開發新的軟件解決方案；**產品開發中心**主要負責按個別基準升級和進一步開發現有模塊；**核心研發中心**主要負責開發和升級我們的平台；**解決方案諮詢中心**主要負責根據客戶需求設計最佳軟件解決方案並追蹤其實施情況。詳情請參閱「業務－研發－研發能力及中心」一節。

根據我們對[編纂]淨額部分擬定用途的未來計劃，我們新的研發中心和職能部門將針對以下三個領域進行定制和規劃：(i)增強我們的CIM產品能力和解決方案，目標是將我們針對12英寸晶圓製造的MES場景覆蓋能力從目前內部評估的63分提升至85分以上，實現研發能力的預期增長；(ii)構建我們在泛半導體產業人工智能應用方面的能力，加上CIM產品場景的整合發展，我們的目標是通過建立CIM+AI的競爭優勢來實現研發能力的預期增長，目標是在我們的產品應用場景中實現每年15%的AI整合率；(iii)建立我們高端工藝設計與模擬解決方案開發的研發能力，目標是通過將我們的電子束模擬及校正能力從目前的50納米製程提升至7納米節點能力，以實現研發能力的預期增長。

### 戰略合作

約[編纂]%或[編纂]港元將用於選擇性地尋求國內外戰略聯盟、投資、併購機會。在評估投資或收購機會時，我們將主要考慮能與我們的產品組合互補、且符合我們的企業理念與發展策略的目標公司。我們的潛在目標包括工業AI和生態整合領域的公司，以及其他能讓我們探索新的市場機會，並擴展我們在泛半導體行業足跡的公司。通過與該等公司的戰略併購，我們預期將在工業AI及生態整合領域建立穩固地位，從而提升我們在泛半導體IMSS市場的市場份額。

我們的收購策略採用定量挑選標準，針對市值介於160百萬港元至240百萬港元之間、淨利率約為10%、且連續兩年盈利能力良好的公司，並結合定性評估技術協同效應和市場准入潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，中國工業軟件行業（主要集中在華東）存在約200個合適目標。董事認為，該等已完成收購預期將於整合後12個月內增加盈利，貢獻每年約50百萬港元至200百萬港元的增量收入，同時維持本集團整體毛利率

## 未來計劃及[編纂]用途

在15%以上；然而，由於本集團擬透過內部資源及[編纂]支付前期代價，該等交易可能暫時增加整合期間的行政費用，並可能對短期現金流造成不利影響。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何潛在的收購目標。經考慮尋找合適的投資或收購目標、進行必要的評估和盡職審查以及與交易對手商定投資或收購的商業條款所需的時間，我們預計目標投資或收購將於2027年年底進行並完成。

### 銷售及推廣

約[編纂]%或[編纂]港元將自2026年起用於通過以下方式提升我們的商業化能力：擴展國內外銷售與服務網絡，以及提升客戶服務質量以維持並深化現有客戶關係：(i)擴充國內外銷售與服務團隊；及(ii)支持本土化營銷與品牌推廣活動來進一步提升我們品牌的知名度，擴大我們的客戶群。具體而言，我們將定期參與海內外展會活動以及行業會議和研討會，並開展營銷活動以向潛在客戶推廣我們的IMSS。

海外擴張計劃方面，我們已將越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度及中東確定為我們的主要海外目標市場，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場對光伏、PCB及半導體產業的全球轉移至關重要。我們已完成對目標市場的區域產業結構、客戶分佈及競爭格局的全面評估並已對目標市場進行詳細的可行性研究，分析行業發展趨勢、在建或計劃中的工廠、人工成本及當地生態系統。有關我們海外擴張計劃的詳情，請參閱「業務－我們的策略－加速海外佈局，賦能中國企業，推動中國智能製造技術走向世界」。

2025年8月，我們於東南亞訂立了我們的首個海外項目，合約總額約6.7百萬美元，涉及跨平台系統模塊。該項目不僅展示了我們承接複雜跨境項目的能力，也為我們拓展全球業務奠定了堅實的基礎。於2025年，我們與海外客戶訂立若干合約，包括在印度執行全廠CIM項目的工作訂單、在印度尼西亞、越南和埃及的太陽能生產線項目、台灣客戶的MCS項目。於最後實際可行日期，我們正與海外半導體封裝／測試客戶磋商，並正在探索台灣地區市場設施數字化項目，其中一些項目已進入合約最終確定和實施階段，這證實了明確且可行的海外需求。

### 營運資金

約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。倘[編纂]淨額高於或低於預期，則我們將就以上用途按比例增加或減少[編纂]淨額的分配。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股[編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）計算，並扣除本公司應付的[編纂]費用及佣金後，本公司將就因[編纂]獲悉數行使而將予配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元。額外籌集的款項將按比例用於上述[編纂]用途。

倘我們發展計劃的任何部分因各種原因而未能如期進行，如政府政策的變動導致我們的計劃發展不再可行，或發生不可抗力事件，我們將審慎評估形勢及或會重新分配[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額並未即時用作上述用途，我們會將未使用的[編纂]存入持牌商業銀行或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。